

昇陽半導體2025年第一季法說會

Q1 2025

免責聲明

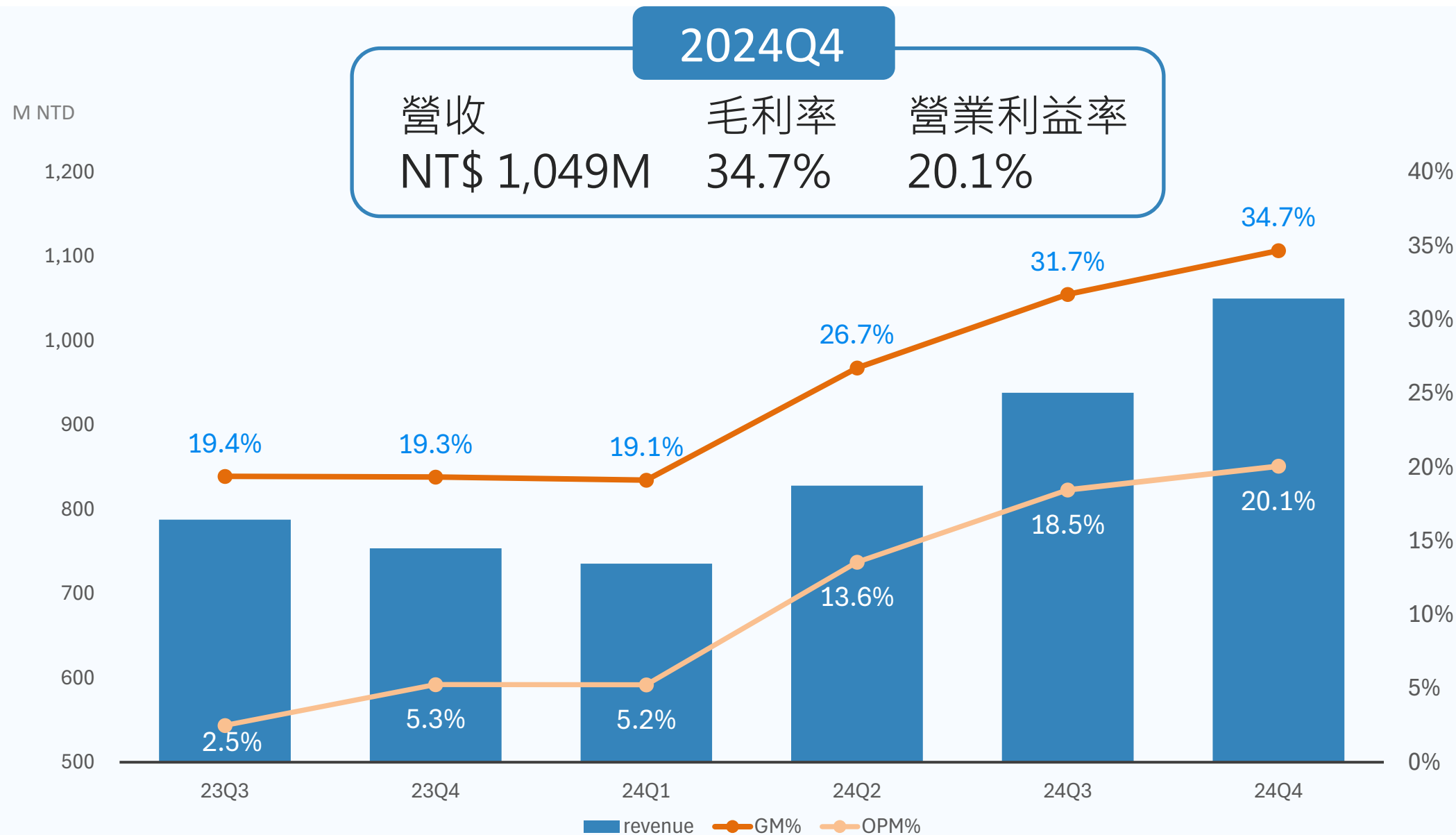
- 昇陽半導體對其目前期望的陳述是前瞻性陳述，受到重大風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的內容有重大差異。
- 有關可能導致實際結果變化的因素的資訊，可在昇陽半導體向台灣證券交易所公司（TWSE）提交的年度或季度報告以及PSI不時向TWSE提交的其他文件中找到。
- 除非法律有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因
- 此份報告的數字是按照國際財務報導準則（IFRS）編制的

議程

- 財務表現
- 市場趨勢與競爭分析
- 產品與技術更新
- PSI關鍵訊息

財務表現

財務重點



財務重點

Item	2024Q4	2024Q3	2023Q4
晶圓出貨量 (千片十二吋約當晶圓)	1,963	1,803	1,519
營業收入淨額 (新台幣百萬元)	1,050	938	754
營業毛利率	34.7%	31.7%	19.3%
營業淨利率	20.1%	18.4%	5.2%
純益率	19.0%	13.4%	2.3%
每股盈餘 - (新台幣元)	1.16	0.73	0.01
股東權益報酬率 (年化)	19.9%	13.0%	2.4%
營業現金流 (新台幣百萬元)	449	447	182
資本支出 (新台幣百萬元)	549	464	238
自由現金流量 (新台幣百萬元)	-57	-17	-99

營收與出貨成長：受惠於晶圓出貨量提升，年增與季增動能持續。

毛利率擴張：受規模效益與UTR提升帶動，毛利率由去年同期的19.3%上升至34.7%。

獲利能力：每股盈餘攀升至1.16，季度表現大幅改善。

現金流與資本支出：因產能擴充，短期自由現金流受影響，為未來成長奠定基礎。

市場趨勢與競爭分析

市場趨勢—Deep Seek 解析

影響分析:

1. 成本效益提升—優化半導體運營
2. 推升邊緣AI滲透率與設備創新應用

昇陽的機會:

1. 供應限制瓶頸仍在，短期內無明顯影響
2. 半導體耗材與代工服務需求持續增長

市場趨勢 – 美國關稅

影響分析:

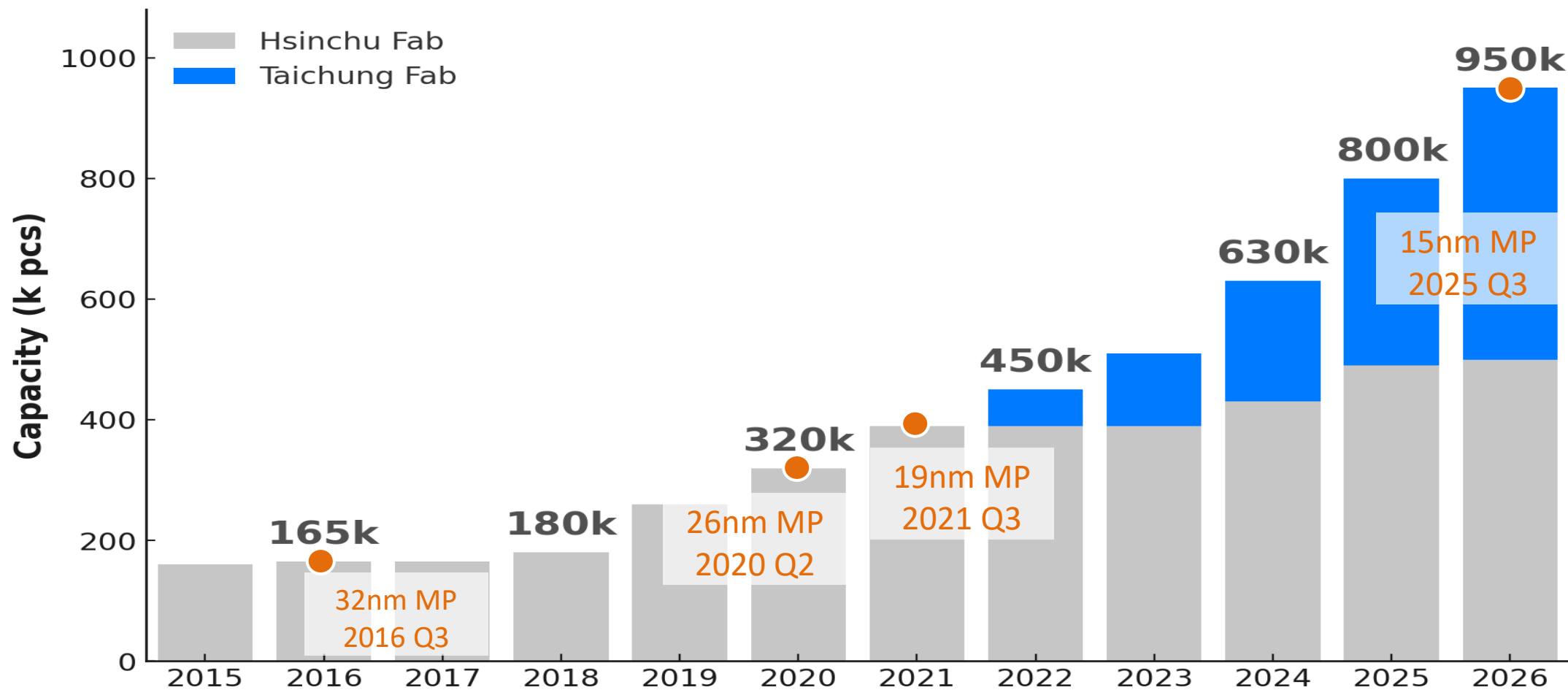
1. TSMC 增加投資 1000 億美元於美國擴產
2. 供應鏈轉移，逐步轉至本地供應商
3. 再生晶圓進口可能面臨高額關稅

昇陽的策略應對:

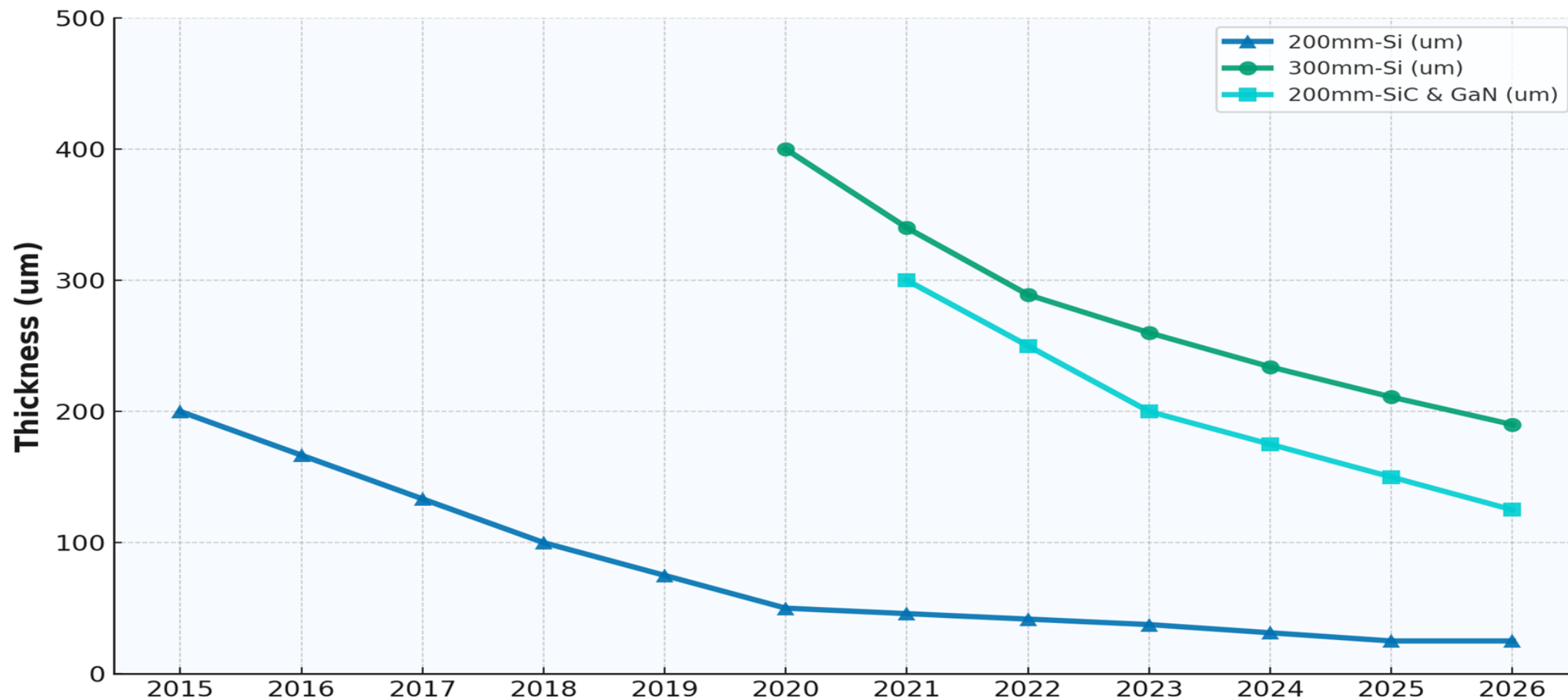
1. 短期內持續（甚至增加）從台灣供應
2. 評估美國產業生態，以確定最佳落地策略
3. 與客戶合作，重新定義晶圓供應流向

產品與技術更新

全球第一再生晶圓產能與品質



晶圓薄化 更薄、更大、邁向新材料



技術重點發展

- 晶圓再生已準備好支援 2nm 節點
測試晶圓生產逐步放量
- 12" BGBM 認證
- 承載晶圓認證
 - ✓ 先進封裝
 - ✓ HBM 堆疊

2026

2025

- 2nm 節點的再生晶圓量產
- 承載晶圓生產放量
- BSPDN承載晶圓認證
- 8 吋 GaN/SiC BGBM 試產
- 12 吋 Si BGBM 量產

PSI關鍵訊息

引領未來 收穫豐碩

■ 持續保持再生晶圓業務的領先地位

- 積極擴產，以確保未來三年客戶需求無虞
- 評估 2028 年後在台灣與美國的擴展機會

■ 在核心競爭力內探索新業務領域

- 自 2025 年起拓展測試/載板晶圓業務
- GaN 和 SiC 薄化業務未來三年快速成長

■ 提升股東報酬

- ROE% 和 EPS 持續逐年大幅成長
- 穩健的股利政策，平衡再投資與股東回報

<https://www.psi.com.tw>
ir@psi.com.tw
